

LDM182G5005CC001

生産中

推奨

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

包装情報

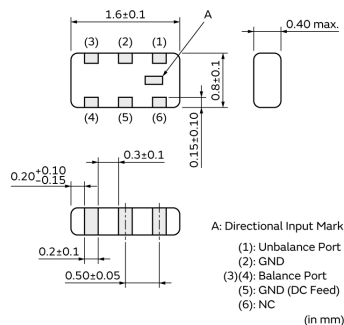
包装コード	仕様	標準梱包数量
-	180mm紙テーピング	4000

特長

銅パターンと誘電体により構成された、高周波対応のチップ、SMDタイプのバランです。

1. 小型、薄型、SMDタイプのバラン。
2. 低損失を実現。
3. テーピング包装を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。

外観および形状



お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LDM182G5005CC001



スペック

中心周波数	2500.00MHz
周波数範囲	2300.00MHz ~ 2700.00MHz
挿入損失 I)	0.90dB max. (at 25℃)
挿入損失 II)	1.00dB max. (-40~+85℃)
不平衡端子インピーダンス (公称値)	50Ω
平衡端子間インピーダンス (公称値)	50Ω
不平衡端子VSWR	2.00 max. (平衡端子 間:50Ω時)
使用温度範囲	-40℃ ~ 85℃
LxW寸法	1.60x0.80mm
T寸法(max.)	0.4mm

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。